

中微半导体设备（上海）股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议审议的相关事项的

事前认可意见

我们收到中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年7月9日以现场会议加电话会议的方式召开公司第一届董事会第二十一次会议的通知，对本次会议拟审议的《关于向参股公司提供借款的议案》进行了认真的审核。

我们认为：

公司向参股子公司 Solayer GmbH（以下简称“Solayer”）提供借款系公司按照公平、公正、公开原则开展，有利于保障 Solayer 经营和研发的顺利推进；Solayer 其它股东亦共同提供借款；本次向参股公司提供借款，不会对公司日常经营产生重大影响，亦不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将此事项提交公司第一届董事会第二十一次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

2021 年 7 月 5 日

（以下无正文）

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议审议的相关事项的事前认可意见》的签署页）

陈大同

签 署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈大同' (Chen Datong), written over a horizontal line.

(本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议审议的相关事项的事前认可意见》的签署页)

Chen, Shimin (陈世敏)

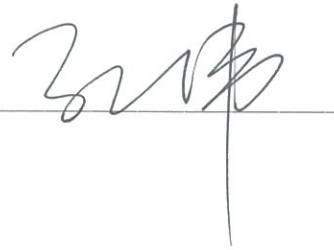
签 署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈世敏' (Chen Shimin), written over a horizontal line.

(本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议审议的相关事项的事前认可意见》的签署页)

孔伟

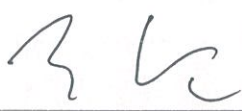
签 署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孔伟' (Kong Wei), written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the end of the signature.

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议审议的相关事项的事前认可意见》的签署页）

张卫

签署：

_____